

⑪ 公開実用新案公報 (U) 昭61-96548

⑤Int.Cl.

H 01 L 23/12
23/52

識別記号

厅内整理番号
7357-5F
6428-5F

④公開 昭和61年(1986)6月21日

審査請求 未請求 (全2頁)

⑥考案の名称 半導体装置

⑦実願 昭59-181752

⑧出願 昭59(1984)11月30日

⑨考案者 村竹清 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑩出願人 富士通株式会社 川崎市中原区上小田中1015番地

⑪代理人 弁理士 松岡宏四郎

⑫実用新案登録請求の範囲

グリーンシートの複数層を積層し焼結して作る半導体パッケージにおいて、各層に電気的導通のため設けるスルーホールを、一方端の径は他方端の径よりも大に形成することによりテーパ状にし、かかるスルーホールに導電性充填材を充填してなることを特徴とする半導体装置。

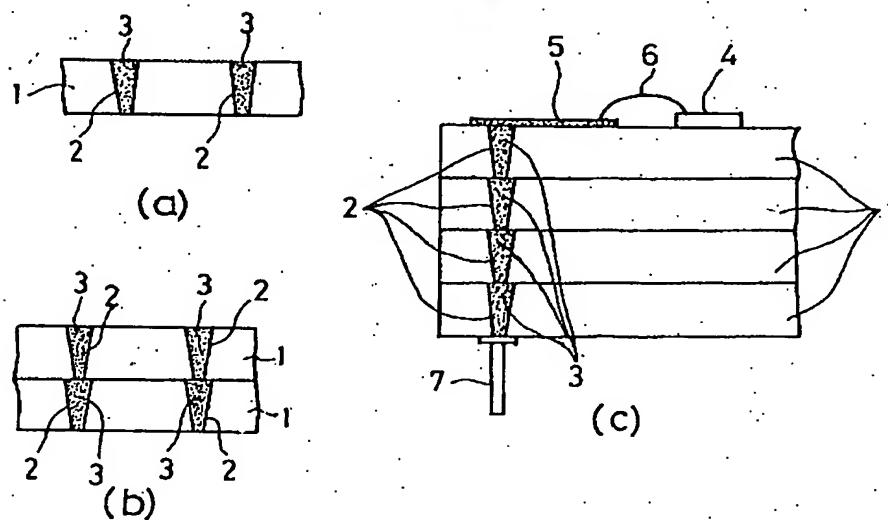
図面の簡単な説明

第1図aは本考案にかかるグリーンシートの断面図、同図bはそのaに示すグリーンシートを積層した構造を示す断面図、同図cはそのaのグリ

ーンシートを用いて作った半導体パッケージの一部の断面図、第2図aは従来例グリーンシートのスルーホールを示す断面図、同図bはそのaのスルーホールにピアホールを加えた構造を示す断面図、同図aはそのbに示すグリーンシートが積層された構造を示す断面図である。

図中、1はグリーンシート、2はピアホール、3は導電性充填材、4は半導体チップ、5はメタライズ層、6はワイヤ、7はピン、をそれぞれ示す。

第1図



第2図

